

招商证券股份有限公司  
关于深圳市强达电路股份有限公司  
向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

**CMS**  **招商证券**

深圳市福田区福华一路 111 号

## 声 明

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）接受深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“强达电路”）的委托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构。

本保荐机构及相关保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行承销业务实施细则》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《深圳市强达电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。

## 目 录

声 明 .....	1
目 录 .....	2
一、公司概况 .....	3
(一) 发行人基本情况 .....	3
(二) 发行人主营业务 .....	3
(三) 发行人核心技术及研发水平 .....	6
(四) 发行人主要经营和财务数据及指标 .....	11
(五) 发行人存在的主要风险 .....	12
二、本次证券发行基本情况 .....	21
三、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 .....	22
(一) 保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 .....	22
(二) 保荐代表人主要保荐业务执业情况 .....	22
(三) 项目协办人主要保荐业务执业情况 .....	23
(四) 保荐代表人、协办人、其他项目成员的联系地址及联系方式 .....	23
四、保荐机构与发行人存在的关联关系 .....	23
五、保荐机构的承诺 .....	24
六、本次证券发行的决策程序 .....	25
(一) 发行人董事会对本次证券发行上市的批准 .....	26
(二) 发行人股东会对本次证券发行上市的批准、授权 .....	26
七、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明 .....	26
(一) 发行人符合《证券法》有关规定 .....	26
(二) 发行人符合《上市公司证券发行注册管理办法》有关规定 .....	28
八、保荐机构关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断 以及相应理由和依据，以及保荐机构的核查内容和核查过程 .....	39
(一) 保荐机构关于发行人符合板块定位及国家产业政策的说明 .....	39
(二) 保荐机构的核查内容和核查过程 .....	40
九、保荐机构对发行人持续督导期间的工作安排 .....	41
十、保荐机构认为应当说明的其他事项 .....	43
十一、保荐机构对本次证券上市的推荐结论 .....	44

## 一、公司概况

### （一）发行人基本情况

中文名称：深圳市强达电路股份有限公司

注册地：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 3 号福发工业园 A-1 栋厂房 101-401（一照多址企业）

有限公司成立时间：2004 年 5 月 31 日

股份公司成立时间：2021 年 7 月 27 日

联系电话：0755-29919816

联系传真：0755-29919826

联系人：周剑青

互联网网址：<https://www.qdcircuits.com>

电子信箱：[ir@qdcircuits.com](mailto:ir@qdcircuits.com)

### （二）发行人主营业务

公司深耕 PCB 行业二十余年，主营业务为 PCB 的研发、生产和销售，是一家专注于中高端样板和小批量板的 PCB 企业。公司凭借快速响应、柔性生产、精细管理、智能制造和优异的服务水平，致力于满足客户电子产品在研究、开发、试验和小批量阶段对 PCB 的专业需求，产品广泛应用于工业控制、通信设备、汽车电子、消费电子、医疗健康和半导体测试等应用领域。

公司 2004 年创立于深圳，抓住国内 PCB 行业早期缺少中高端样板产能的市场机遇快速发展。公司通过多年积累，构建和改进适用于中高端样板和小批量板的柔性生产、精细管理和智能制造模式，培育发展个性定制、柔性制造等新模式，既能满足客户大量的定制化和多样化产品需求，又能保证产品及时交付。2018 年 3 月，随着江西工厂投产，经过产能爬坡和工艺磨合，以及深圳工厂的生产订单转移和产品定位调整，公司逐渐提升生产效率、突破产线混合和产能瓶颈的限制，

产品型号增加和产品层数提高。深圳工厂主要定位为中高端样板和部分特殊工艺或特殊材料的批量板，江西工厂主要定位为快速交付的批量板。2019年以来，在产业政策支持和行业快速发展的推动下，公司成长为聚焦中高端样板和小批量板业务，并在样板市场具有领先地位的PCB企业。

2021年12月，公司设立全资子公司南通强达作为募投项目的实施主体，未来项目建成后，公司将形成深圳工厂、江西工厂和南通工厂三大生产基地。其中，深圳工厂主要定位中高端样板，江西工厂主要定位快速交付的小批量板，南通工厂主要定位新兴产业应用的中高端小批量板，面向具有一定差异化的客户、区域和产业领域，相互补充、相互协同。南通工厂定位于高多层板、HDI板产品，将按照智能工厂和数字化车间的标准建设，随着电子产业市场持续技术革新，公司不断投入研发技术，有利于提升PCB生产工艺的新质生产力。

二十年来，公司主营业务紧跟国家经济发展战略和产业政策导向，主要产品为中高端样板和小批量板，属于新兴产业重点产品，是加强国内电子产业基础能力建设的关键环节。为支持和顺应下游电子产品新兴应用领域发展，公司发挥长期坚守的“工匠精神”，始终坚持中高端样板和小批量板的产品定位，持续提升自身的PCB工艺制程能力、拓宽新兴PCB产品型号，通过技术创新带动PCB产业高质量发展。公司PCB产品应用领域覆盖的行业广泛，且下游电子产业正处于技术创新变革期间，电子产品所涉及的应用领域新、技术含量高，要求PCB产品需高度迎合行业变化需求，推动下游电子产业研发进度，为下游电子产业的新产品培育新质生产力。

公司PCB产品按订单面积分为样板、小批量板和大批量板，按产品层数分类为单/双面板和多层板。2024年度，公司样板、小批量板和大批量板占PCB产品收入的比例分别为53.79%、32.50%和13.70%；单/双面板和多层板占PCB产品收入的比例分别为15.37%和84.63%。公司覆盖的客户领域众多、产品应用领域广泛，在与客户的合作过程中，形成了大量涵盖特殊工艺或特殊材料的中高端PCB工艺制程能力，打造了丰富的定制化PCB产品体系。公司特殊工艺或特殊材料的中高端PCB产品主要包括：高多层板、高频板、高速板、HDI板、厚铜板、刚挠结合板、半导体测试板和毫米波雷达板等。

公司订单呈现“多品种、小批量、高品质、快速交付”的需求特点。2024年，公司销售的PCB型号超过10.88万款，平均订单面积2.61平方米，其中样板和小批量板的平均订单面积分别为0.69平方米和13.57平方米。公司PCB产品可实现快速交付，单/双面板最快可24小时内交付，多层板最快可48小时内交付。2024年，公司PCB产品交付周期一般为5-10天，其中样板和小批量板的平均交付周期分别约为6天和9天，公司交付周期快于业内平均水平。

公司创始团队成员来自于深南电路、崇达技术等PCB业内优质上市公司，具有二十年以上PCB产品的研发、设计、生产、销售和管理经验。公司现有管理团队和研发团队长期稳定，在中高端样板和小批量板的专业领域积累了深厚的管理经验和研发经验。同时，公司在技术中心、工艺部、工程部和品质部等相关部门的通力协作下，形成多项中高端PCB产品专利技术或专有技术。

公司是高新技术企业、中国电子电路行业协会（CPCA）协会会员单位和深圳市线路板行业协会（SPCA）监事单位，也是国家级专精特新“小巨人”企业，公司全资子公司江西强达是高新技术企业和江西省“专精特新”中小企业。公司连续多年被中国电子电路行业协会评为中国电子电路行业百强企业，其中2022-2024年公司在综合PCB企业中排名分别为第80位、第82位和第81位，在内资PCB企业排名分别为第48位、第53位和第53位。此外，公司2021年作为“快板/样板”企业入选中国电子电路行业协会评选的“特色产品主要企业”十大企业榜单。

公司长期聚焦于中高端样板和小批量板市场，在与不同领域的众多客户合作中形成PCB工艺制程能力。公司PCB主要制程能力达到行业主流水平，产品最高层数可达50层，内层最小线宽/线距最小为2.0mil/2.0mil，机械钻孔最小孔径为4.0mil，激光钻孔最小孔径为3.0mil，最大厚径比为25:1，最大铜厚为30盎司。公司自主研发的“77GHz毫米波雷达PCB关键技术及产业化”项目已通过科学技术成果评价，达到国内领先水平。同时，公司将通过募投项目南通工厂的建设，进一步提升PCB主要制程能力，可实现产品最高层数60层，内层最小线宽/线距和外层最小线宽/线距均为40μm/40μm，机械钻孔最小孔径为3.0mil，激光钻孔最小孔径为3.0mil，最大厚径比为30:1。

报告期内，公司服务的活跃客户近 3,000 家，主要客户有上市公司近百家，公司与客户关系长期稳定。客户主要包括电子产品制造商、PCB 贸易商和 PCB 生产商，均具备 PCB 行业专业的生产、制造或贸易经验。公司与大多数主要客户具有近十年的合作关系，长期稳定的客户资源为公司业绩增长和未来发展奠定了坚实的基础。公司客户中，电子产品制造商主要包括华兴源创（688001.SH）、Scanfil（斯凯菲尔）、Phoenix（菲尼克斯）、FIDELTRONIK、易德龙（603380.SH）、盛景微（603375.SH）、长川科技（300604.SZ）等客户，PCB 贸易商主要包括 Fineline、PCB Connect（科恩耐特）和 ICAPE（艾佳普）等客户，PCB 生产商主要包括 Würth（伍尔特）和 HT（环球线路）等客户。

公司 PCB 产品销售区域广泛，境内销售与境外销售共同发展。2024 年度，公司境内销售和境外销售占 PCB 产品收入的比例分别为 70.63% 和 29.37%。公司境内销售集中在华东、华南和华北等区域，境外销售以欧洲区域为主。

### （三）发行人核心技术及研发水平

自成立以来，公司一直专注于中高端样板和小批量 PCB 生产制造，坚持自主研发。基于优秀的技术研发团队和公司的技术创新能力，以及二十年来在中高端样板和小批量板领域生产工艺技术的开发经验，公司在高多层、超厚铜、HDI 板、高频高速板、特种板和其他特殊加工等工艺技术方面具备深厚的积累，形成多项核心技术。

公司积累了一定数量的重要专利、非专利技术。公司主要核心技术如下：

技术类别	核心技术名称	主要专利号/专有技术	技术来源	应用情况	核心技术特点
高多层板	超高层工艺	ZL202011126109.1 ZL201910642638.8	自主研发	样板：8-50 层 批量板：8-32 层	1、公司高多层板的最高层数可达 50 层，内层孔到线 7mil，通过真空蚀刻技术、激光直接成像技术，实现更高精度的线宽，同时通过工艺改进提高多层板的生产效率。 2、公司高多层和超高多层工艺已形成“一种多层 PCB 高精度内层压合方法”和“一种多层印刷电路板加工用铆合夹接装置及其工作方法”等发明专利。 3、公司高多层板核心技术，解决线路板间涨缩系数的匹配及生产参数的制定，多张芯板压合层间对准度，提高钻孔加工能力及钻孔参数收集，解决高厚径比电镀镀孔问题。
	超高厚径比钻孔工艺	ZL201920236203.9	自主研发	样板 25:1-40:1 小批量板 16:1-25:1 大批量板 <16:1	
	电镀工艺	ZL202120244055.2	自主研发	样板和批量板	
	镀孔工艺	ZL202021192460.6	自主研发	样板和批量板	
厚铜板	超厚铜板件工艺	ZL201920198575.7 ZL202420617605.4	自主研发	样板 30 盎司 批量板 12 盎司	1、公司铜厚可达 30 盎司，阻值公差样板和小批量板可实现小于 10%，铜厚均匀性控制在 $\pm 3 \mu\text{m}$ 以内。 2、公司将双面板中的铜厚分开制作，线路制作完成后将其压合，并进行钻孔、沉铜、图形转移等正常工序，可降低超厚铜板蚀刻难度，提高铜厚均匀度。 3、厚铜产品压合填胶困难，需要多张 PP，采用树脂填线路间隙后，进行滚压整平烤板，降低压合制作难度，减少 PP 使用量及降低成本，提高板厚均匀性
	线圈阻值板工艺	ZL202021820833.X	自主研发	样板和小批量板 <10% 大批量板 ≥10%	
高密度互连板 (HDI 板)	多阶高密度互连板工艺	ZL202021193845.4 ZL201920208821.2	自主研发	样板：任意 1-6 阶 批量板：任意 1-4 阶	1、公司利用高均匀性能力垂直连续电镀设备（VCP）以及高解析度曝光机和干膜，实现最小线宽/线距为 2mil/2mil，铜厚均匀性控制保证 R 值在 $5 \mu\text{m}$ 以内，以及目前最高实现 6 阶任意互连。 2、公司高密度互连板技术通过曝光机对位保证图形对位精准，精度控制在 $10 \mu\text{m}$ 以内，压合采用融合加铆合以提高层压对准度，激光打孔测试调整比例，达到叠孔一致性，电镀填孔凹陷度控制在 $15 \mu\text{m}$ 以内。 3、公司“树脂塞孔 PCB 板除胶打磨台”实用新型专利已授权，可
	电镀填孔工艺	ZL202021192460.6	自主研发	样板和批量板	
	多次压合盲埋孔工艺	ZL202021193845.4 ZL202222921223.4 ZL202421965443.X	自主研发	样板和批量板	

技术类别	核心技术名称	主要专利号/专有技术	技术来源	应用情况	核心技术特点
高频板 高速板	树脂塞孔工艺	ZL202020824485.7	自主研发	样板和批量板	减少树脂塞孔生产过程中的树脂打磨流程，减少因打磨造成的品质问题，有效提升树脂塞孔工艺的效率。 4、通过精准的内靶标定位，激光盲孔孔位精度控制在1mil以下，提高孔位精度；通过特殊激光孔检测装置，对激光孔进行漏孔、多孔、孔位等进行检测，有效的拦截不良品流出，降低成本
	镭射激光孔工艺	ZL202223049780.8 ZL202222784155.1 ZL202320179729.4 ZL202321157915.4	自主研发	样板和批量板	
	毫米波印制板工艺	ZL202320177111.4 ZL202320727217.7	自主研发	样板和批量板	1、汽车电子高级驾驶辅助系统(ADAS)市场规模快速提升，77GHz和79GHz车载毫米波雷达仍属于初级阶段，公司已实现77GHz毫米波雷达PCB生产，“77GHz毫米波雷达PCB关键技术及产业化”项目通过科技成果鉴定，已达到国内领先水平。 2、公司77GHz毫米波雷达板采用薄化相阵天线，有利于减小天线辐射损耗，形成窄波束；优先采用 $18\pm3\mu\text{m}$ 天线铜厚控制；焊盘拐角采用特殊设计，改进钝化长度有利于提高天线增益、抑制频漂和形成雷达窄波束；天线位置局部薄铜设计，一旦EA值超出要求就会影响无线信号的传输和接收，严重情况下将出现信号增益的问题，方盘拐角EA值 $\leq 10\mu\text{m}$ ；实际控制在EA值 $<8\mu\text{m}$ 。
特种板	高频印制板工艺	ZL201510691253.2 ZL202123308490.6	自主研发	样板和批量板	1、公司高多层背板电镀后直接整板镀锡，在镀锡后进行背钻，通过蚀刻解决铜丝问题，蚀刻后树脂塞孔，将背钻塞孔镀平，解决高多层背板层间结构的设计，使得到孔深钻深度公差控制在 $\pm 0.1\text{mm}$ 以内，有效避免高速信号在PCB线路传输的反射、散射、延迟等，增强高速板性能。 2、公司背板阻焊制作方法可以有效解决油墨入孔问题，提高背板良率，降低生产成本。
	背钻工艺	ZL201920236203.9 ZL202123020164.5	自主研发	样板和批量板	
台阶印制板工艺	ZL201920773066.2 ZL202222881612.9 ZL202410494843.5 (发明专利申请中)	自主研发	样板和批量板	1、公司通过正、反锣槽的方式为台阶“揭盖”；增加对微盲孔采用等离子体清洗，等离子体可将钻孔后所残留的碳黑清洁干净，减少回流焊后盲孔脱垫。 2、公司“一种台阶印制电路板”实用新型专利已获授权，“一种台阶印制电路板及其制作方法”发明专利已进入实质审查阶段，该	

技术类别	核心技术名称	主要专利号/专有技术	技术来源	应用情况	核心技术特点
					制作方法有效防止层压溢胶污染台阶底部金属线路，可减少后期除胶难度。
	多张软板的刚挠结合板工艺	ZL202111599206.7 ZL202320814085.1 ZL202420690602.3	自主研发	样板和批量板	1、公司将玻璃树脂粘结片和半固化片分别加热到 180°C，再将两者进行压合，得到两面性粘结片，有效弥补了刚挠结合板的结合强度不足与流胶不规律的缺陷，使刚挠结合板具有完美的抗高温热冲击能力与恶劣环境下的稳定使用效果。 2、公司已获得“用于软硬结合板的两面性粘结片及其制作方法”发明专利的授权；以及公司已于 2025 年 11 月通过“一种硬板被软板围捕的软硬结合板制造方法”发明专利的审核。 3、可实现软板手指电金、压合补强等工艺，客户端使用从焊接一次使用优化为可插拔多次使用。
	镶嵌板工艺	ZL201920198575.7 ZL202021820833.X ZL202222805452.X ZL202222993068.7 ZL202311675280.1	自主研发	样板和批量板	1、公司获得的“一种可快速散热的多层印制 PCB 线路板”实用新型专利，通过第一线路层、第一导热板、印刷保护框、冷却输入管和固定框，解决了多层 PCB 散热效率低、散热不完全和缺少对线路板边角走线的保护问题。 2、公司获得的“一种用于定位铜基 PCB 板压合的工装及 PCB 板”实用新型专利，通过第一销钉定位孔和第二销钉定位孔，提高定位效果。
	陶瓷板	ZL201510691253.2	自主研发	样板和批量板	1、公司已在陶瓷 PCB 方面取得“一种小尺寸、薄纯陶瓷线路板的加工方法”发明专利，该项方法制作陶瓷 PCB 的优点是通过压合溢胶（镶嵌）的方式，形成大的拼板，解决小尺寸、薄纯陶瓷 PCB 加工过程中的易碎性问题，提高工艺效率。 2、公司针对“陶瓷混压 HDI 印制板”进行研发，以实现陶瓷混压钻孔及孔金属化工艺，提高陶瓷混压板工艺流程和成品效率。
特殊工艺	局部电金工艺	ZL201921164327.7 ZL202110615185.7 ZL202421063792.2	自主研发	样板和批量板	局部电厚金高密度互连板性能优异，但市场上广泛制作的局部电厚金 PCB 金厚一般在 1.0μm 以下，公司研发利用高效率的电厚金

技术类别	核心技术名称	主要专利号/专有技术	技术来源	应用情况	核心技术特点
					药水实现金厚 1.0-2.5μm，保证最小金厚 1.0μm，金厚均匀性保证在 70%以上。
阶梯结构金手指工艺	ZL201921164327.7 ZL202110615185.7 ZL202420566700.6 ZL202422184646.1	自主研发	样板	1、公司金手指工艺技术上研发出一种阶梯结构金手指工艺，“一种阶梯结构金手指的制作方法”发明专利已获得授权，该种方法通过确定叠层结构、内层线路制作、盖板制作、盖板锣槽、压合、外层线路、揭盖锣槽和电金手指等步骤制作阶梯结构金手指。 2、长短金手指技术开发，可实现长短金手指短手指无引线残留；分节分段金手指技术开发，实现金手指分段位置间距 6mil，实现金手指 3 面包金。	
高精密机械控深钻微盲孔工艺	ZL201920236203.9	自主研发	样板和批量板	公司高精密机械控深钻微盲孔工艺，主要解决了利用机械钻孔设备即可实现 PCB 微盲孔工艺，降低了对激光钻孔设备的依赖，改善高密度互连板激光钻孔后孔形差、除胶困难等问题，以满足表面安装技术（SMT）用 PCB 的需求。	

## (四) 发行人主要经营和财务数据及指标

### 1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日	2023年12月31日	2012年12月31日
流动资产	89,484.54	98,180.13	44,935.50	38,018.63
非流动资产	63,416.97	39,911.67	33,894.05	32,762.85
<b>资产总额</b>	<b>152,901.51</b>	<b>138,091.80</b>	<b>78,829.55</b>	<b>70,781.48</b>
流动负债	32,548.53	24,725.77	22,540.29	22,976.28
非流动负债	5,644.95	5,441.96	5,251.69	6,231.41
<b>负债总额</b>	<b>38,193.48</b>	<b>30,167.73</b>	<b>27,791.98</b>	<b>29,207.69</b>
<b>股东权益</b>	<b>114,708.03</b>	<b>107,924.07</b>	<b>51,037.58</b>	<b>41,573.80</b>
归属于母公司股东权益	114,708.03	107,924.07	51,037.58	41,573.80

### 2、合并利润表

单位：万元

项目	2025年1-9月	2024年度	2023年度	2022年度
营业收入	70,637.72	79,304.14	71,320.74	73,104.13
营业利润(亏损以“-”号填列)	10,837.32	12,670.17	10,062.88	9,765.15
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	10,834.40	12,737.54	10,080.10	9,837.94
净利润(净亏损以“-”号填列)	9,632.37	11,264.82	9,106.41	9,090.07
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	9,632.37	11,264.82	9,106.41	9,090.07

### 3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2025年1-9月	2024年度	2023年度	2022年度
经营活动产生的现金流量净额	9,494.83	10,877.97	13,563.06	10,104.53
投资活动产生的现金流量净额	-10,129.59	-39,990.19	-5,112.21	-5,895.21
筹资活动产生的现金流量净额	-3,999.73	44,234.57	-3,309.72	-2,539.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30.56	38.36	36.12	170.88
现金及现金等价物净增加额	-4,665.05	15,160.70	5,177.26	1,841.07

#### 4、主要财务指标表

项目	2025年9月30日 /2025年1-9月	2024年12月31日 /2024年度	2023年12月31日 /2023年度	2022年12月31日 /2022年度
流动比率(倍)	2.75	3.97	1.99	1.65
速动比率(倍)	2.51	3.73	1.79	1.46
资产负债率(合并)	24.98%	21.85%	35.26%	41.26%
资产负债率(母公司)	24.07%	18.79%	28.09%	32.87%
应收账款周转率(次/年)	2.75	3.60	3.53	3.79
存货周转率(次/年)	6.88	9.91	10.15	9.97
息税折旧摊销前利润(万元)	14,752.07	17,441.57	14,358.80	13,822.58
利息保障倍数(倍)	57.00	46.26	30.46	20.98
归属于母公司所有者的净利润(万元)	9,632.37	11,264.82	9,106.41	9,090.07
归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润(万元)	9,544.51	9,774.50	8,503.24	8,194.72
研发投入占营业收入的比例	5.53%	5.69%	6.10%	6.05%
每股经营活动产生的现金流量(元/股)	1.26	1.44	2.40	1.79
每股净现金流量(元/股)	-0.62	2.01	0.92	0.33
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)	15.22	14.32	9.03	7.35

上述主要财务指标的计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=(流动资产-存货账面价值)/流动负债
- 3、资产负债率(合并)=总负债/总资产×100%
- 4、应收账款周转率=营业收入/(应收账款账面原值期初、期末的均值)
- 5、存货周转率=营业成本/(存货账面原值期初、期末的均值)
- 6、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+当期计提折旧+当期计提摊销
- 7、利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出
- 8、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 9、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加(减少)额/期末总股本
- 10、归属于母公司所有者的每股净资产=期末归属于股东的净资产/期末总股本

#### (五) 发行人存在的主要风险

投资者在评价本次发行及做出投资决定时，除本募集说明书已披露的其他信息外，应慎重考虑下述各项风险因素。

## 1、与公司相关的风险

### (1) 经营业绩下滑的风险

报告期内，公司营业收入分别为 73,104.13 万元、71,320.74 万元、79,304.14 万元和 70,637.72 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 8,194.72 万元、8,503.24 万元、9,774.50 万元和 9,544.51 万元。

公司主营业务为 PCB 的研发、生产和销售，专注于中高端样板和小批量板业务，报告期内服务的活跃客户近 3,000 家。公司销售区域存在境内销售和境外销售，其中内销客户集中度较低，外销客户集中度相对较高。若未来宏观经济环境有所变化，PCB 市场需求整体放缓或下滑，或者公司不能持续巩固和提升竞争优势、市场开拓能力下降等，公司将存在未来经营业绩下滑的风险。

### (2) 公司收入可能无法维持高速增长的风险

报告期内，公司营业收入分别为 73,104.13 万元、71,320.74 万元、79,304.14 万元和 70,637.72 万元，其中 2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-9 月的营业收入分别较上年同期变动-2.44%、11.19% 和 20.74%。2023 年以来，受宏观经济波动等多方面因素的影响，PCB 市场增速减缓、订单趋于平稳、公司产能利用率短暂回落，导致公司 2023 年度的营业收入较上年同期小幅下降；随着 2024 年以来下游回暖、订单增加，公司 2024 年和 2025 年 1-9 月的收入同比有所增加。未来，若 PCB 市场增速持续减缓，主要客户需求下降，公司订单及产能利用率下降等，公司存在可能无法维持收入高速增长甚至经营业绩下滑的风险。

### (3) 技术创新无法满足下游需求的风险

公司专注于中高端样板和小批量板产品，致力于满足客户在研究、开发、试验和小批量阶段对 PCB 的专业需求，产品广泛应用于工业控制、通信设备、汽车电子、消费电子、医疗健康和半导体测试等领域。公司订单呈现“多品种、小批量、高品质、快速交付”的需求特点。

近年来，在 AI、算力等新兴领域技术快速发展的推动下，下游市场对 PCB 产品的技术要求亦相应提高。下游客户对 PCB 产品的集成度、高速信号传输能力、可靠性、散热性等要求持续提升，PCB 产业正朝着满足下游更复杂化电路布

局及更高性能计算需求的方向发展。尽管公司具备研发和技术创新能力，但若公司未能及时跟上行业技术创新趋势，在关键技术研发、工艺升级及产品迭代上未能及时满足客户需求，则可能面临产品竞争力下降、客户资源流失等风险，将对公司经营带来不利影响。

#### (4) 财务风险

##### ①毛利率下降的风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 26.92%、28.74%、27.58% 和 27.76%，其中收入占比 42.87%-54.60% 之间的样板产品的毛利率分别为 43.46%、44.86%、43.46% 和 40.45%，样板产品的毛利率较高。样板具有单笔订单面积小、品种多、快速交付等特点，受产品定价策略、产品类型、工艺要求和竞争程度等因素影响，以及样板产品对 PCB 生产企业的全方面服务能力、柔性化生产管理能力、工艺的多样性和快速交期等方面提出更高要求。一般而言，样板产品的毛利率高于小批量板和大批量板。发行人持续强化中高端样板和小批量板的定位，报告期内，发行人样板和小批量板收入占比合计为 77.99%、83.06%、86.30%、86.79%，其中样板收入占比分别为 42.87%、48.70%、53.79% 和 54.60%。

公司目前已有的深圳强达工厂主要定位中高端样板，江西强达工厂主要定位快速交付的小批量板，本次募投项目南通强达工厂主要定位为高多层板、HDI 板等中高端小批量板。若未来随着小批量板产品收入规模的提高而导致样板产品收入占比下降，公司产品结构发生变化，市场需求放缓或行业竞争加剧导致毛利率较高的中高端样板或特殊工艺的批量板产品收入占比下降或产品价格下降，或公司的核心技术、客户响应速度、工艺多样性等未能满足客户技术发展方向的需求，亦或公司不能有效持续拓展客户并增加市场份额，该类产品的高毛利率不能维持现有水平或出现大幅下降，又或原材料采购价格持续大幅上涨而公司未能通过向下游转移、工艺优化、生产水平提升等方式抵消成本上涨的压力，以及募投项目投产后新增产能难以及时消化或效益不及预期，则公司主营业务毛利率存在下滑的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

##### ②应收账款发生坏账的风险

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 20,046.06 万元、20,333.13 万

元、23,759.17 万元和 27,530.06 万元，占当期营业收入的比例分别为 27.42%、28.51%、29.96% 和 29.23%。若公司主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况和商业信用发生重大不利变化，则可能出现支付困难或发生坏账的情形，对公司的资金周转和生产经营造成不利影响。

### ③存货跌价的风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 4,492.45 万元、4,645.62 万元、5,854.93 万元和 7,700.76 万元，占流动资产的比例分别为 11.82%、10.34%、5.96% 和 8.61%。若未来公司主要原材料和产品价格在短期内发生大幅下降，或因国家政策和市场需求造成客户变更或取消订单计划，从而导致公司产品难以在短期内实现销售，则可能造成存货的可变现净值低于账面价值，需要计提减值准备，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

### ④出口退税政策调整的风险

报告期内，公司出口业务收入占比呈下降趋势，但仍占有一定比重，公司主要产品出口适用退税率 13%。增值税属于价外税，增值税免抵退税额并不直接影响公司损益，但其中不予抵扣部分会作为增值税进项税额转出而增加企业的营业成本。如果国家对出口产品的退税率进行进一步调整，出现大幅调低公司主要产品出口退税率的情况，将可能对公司的经营业绩产生不利影响。

## （5）房屋租赁的风险

截至本上市保荐书出具日，公司租赁的位于深圳市宝安区福发工业园的主要房屋及建筑物无产权证书，无法根据产权证书确定租赁物业产权权属，存在因租赁物业权属不清无法继续使用租赁物业的风险。若未来该等租赁地块因土地整备计划或城市更新计划被收回，或者房屋被政府部门依法责令拆除、改变用途等，将可能导致公司产生停工、搬迁等损失，进而对公司生产经营产生不利影响。

## （6）内控风险

### ①业务规模扩大导致的管理风险

本次发行可转债并上市后，随着本次募投项目的建成达产，公司的产能也将大幅提升。公司经营规模、产品型号、客户数量和应用领域将不断扩大，以及在

深圳、江西和南通等不同的生产基地同时开展生产，对公司采购、市场开拓、生产、研发、资源整合和持续创新等方面的管理体系、管理水平和人员素质都提出了更高的要求。

PCB 产品生产涉及的工序众多、工艺流程相对复杂、产品种类繁多和参数多变，随着公司业务规模的提高将加大对经营决策和柔性化管理等方面难度。若公司不能保持目前在交期、对客户需求快速响应的能力以及在柔性化管理等方面的优势，可能会出现服务能力下降、交期延长和成本上升等风险，公司将面临老客户流失、新客户开拓和新增产能消化的风险，从而对公司生产经营产生不利影响。

### ②环保的风险

PCB 产品的生产过程中，会产生废水、废气及固体废弃物。如果公司的环保治理、“三废”排放不能满足监管要求，将可能导致公司受到罚款、停限产等监管措施，从而对公司的生产经营造成不利影响。此外，国家及地方政府可能在将来颁布更严格的环境保护法律法规，提高环保标准，公司可能需要进一步增加环保投入以满足监管部门对环保的要求，将导致经营成本增加。

### ③安全事故的风险

PCB 企业普遍在生产过程中存在生产工序长、大型机器设备多、生产员工众多的特点。随着公司业务规模的不断扩大以及相关设施、设备的老化，如不能始终严格执行各项安全管理措施，不断提高员工的安全生产能力和意识，及时维护、更新相关设施、设备，公司存在发生安全事故的风险，对员工人身及公司财产安全造成损失，对公司经营造成不利影响。

## 2、与行业相关的风险

### (1) 宏观经济波动的风险

PCB 作为电子产品和信息基础设施不可缺少的基础电子元器件，公司所处 PCB 行业下游应用涉及工业控制、通信设备、汽车电子、医疗健康、半导体测试等多个领域，PCB 行业与宏观经济形势密切相关。

由于目前全球受贸易摩擦、地缘政治等因素影响，国内外宏观经济形势可能

存在不稳定的情况。若未来宏观经济发生波动，PCB 市场产值增长速度可能存在放缓或下滑的风险，对公司经营业绩造成不利影响。

### （2）市场竞争加剧的风险

全球 PCB 行业竞争格局较为分散，生产厂商众多，市场竞争充分。随着近年来行业内领先的国内印制电路板企业纷纷建厂扩产，大型的印制电路板企业在批量板的竞争优势可能将愈发凸显，未来市场竞争可能加剧，导致行业加速洗牌，行业集中度逐步提升。公司专注于中高端样板和小批量板市场，与行业龙头企业相比，公司在业务规模、市场占有率等方面存在一定的差距，若公司未能持续提高技术水平、生产管理能力和产品质量以应对市场竞争，则存在因市场竞争加剧导致盈利下滑的风险。

### （3）主要原材料价格波动的风险

报告期内，公司 PCB 业务直接材料成本占比分别为 51.09%、46.72%、46.73% 和 49.73%，其中覆铜板、铜箔、铜球等含铜材料成本占直接材料的比例较高，公司主要原材料价格波动，尤其是含铜材料价格波动对公司产品生产成本影响较大。公司采购覆铜板、铜箔、铜球等含铜材料与铜价呈正相关关系，故公司主要原材料价格波动和铜价波动将对公司主营业务成本产生影响，进而影响公司毛利率。

报告期内，2022 年 1 月至 6 月铜价持续在高位震荡，2022 年 6 月中下旬至 7 月铜价大幅下跌后逐步回调；2023 年铜价整体波动下行并处于较低水平；2024 年第一季度开始大幅上涨至高位后有所回落，2025 年以来呈波动上行趋势。2024 年度和 2025 年 1-9 月，铜价上涨叠加需求回暖，带动覆铜板、铜球和铜箔等主要含铜原材料采购均价的提升。根据测算，假设其他条件不变，若公司原材料价格分别上涨 10% 和 20%，报告期内公司主营业务毛利率下降幅度分别在 3.32-3.73 个百分点之间和 6.64-7.45 个百分点之间；若公司主要原材料中含铜材料价格分别上涨 10% 和 20%，报告期内公司主营业务毛利率下降幅度分别在 1.91-2.25 个百分点之间和 3.82-4.50 个百分点之间。因此，若公司覆铜板、铜箔、铜球等主要含铜材料价格受铜价影响而大幅波动，公司亦未能合理调整报价基准，顺畅地将原材料价格上涨的压力传导至下游客户或未能通过工艺优化、提升生产水平等抵消成本上涨的压力，导致价格传导速度及提价幅度不及原材料上涨幅度，又或

者客户在铜价下跌时要求公司下调价格，公司主营业务毛利率以及盈利情况存在快速下滑的风险。

#### （4）汇率波动的风险

报告期内，公司主营业务外销收入分别为 28,407.98 万元、25,159.25 万元、22,293.52 万元和 19,529.02 万元，其中 PCB 外销收入分别为 28,265.15 万元、24,935.45 万元、22,158.06 万元和 19,440.58 万元，占当期 PCB 业务收入的比重分别为 40.26%、36.49%、29.37% 和 28.83%。报告期内，公司外销收入主要以美元定价和结算，汇兑损益分别为 616.62 万元、165.89 万元、390.40 万元和 58.51 万元。若未来汇率发生较大变化，将会引起公司以外币结算的外销收入产生变化，外汇收支相应会产生汇兑损益，汇兑损益的大幅变动可能会对公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润产生较大不利影响，进而可能会影响公司经营业绩造成不利影响。

#### （5）国际贸易摩擦的风险

报告期内，公司主营业务外销收入分别为 28,407.98 万元、25,159.25 万元、22,293.52 万元和 19,529.02 万元，分别占当期主营业务收入 40.36%、36.67%、29.47% 和 28.90%，外销客户以欧洲地区为主。现阶段，中国大陆已经成为全球最大的 PCB 生产基地，且具备较强的产能消化能力。但随着国际政治局势的变化、全球经济环境的周期性波动，未来阶段的国际贸易政策变化仍存在不确定性，部分国家仍可能对中国大陆 PCB 产品采取如加征关税、进口配额等贸易壁垒措施、贸易保护主义政策。若未来国际贸易保护主义政策持续趋严，可能对全球经济和产业链竞争格局带来冲击，对公司所处 PCB 行业造成不利影响。

### 3、其他风险

#### （1）募集资金投资项目相关风险

##### ①募集资金投资项目实施的风险

本次募集资金投资项目的成功实施需要结合经济形势、产业政策、市场环境、行业竞争态势、技术发展等外部条件与公司自身的生产经营、组织管理、市场营销的执行能力。如果上述因素发生重大不利变化，则存在募集资金不能足额到位，

或项目管理、建设工期、设备安装调试、量产达标以及市场开发等方面不达预期的风险，进而影响项目的投资回报和预期收益。

#### ②募投项目投产后的产能消化和收益不及预期风险

公司本次募投项目“南通强达电路科技有限公司年产 96 万平方米多层板、HDI 板项目”建成投产后，公司将新增年产 96 万平方米多层板、HDI 板产能。南通强达工厂计划在 T+3 年开始逐步投产、释放产能，并在第 T+6 年完全投产，届时 PCB 产能将大幅提高，同时新增产能为中高端产品，产品定位、区域市场、客户需求、市场竞争等方面均与目前情况有较大差异。若未来 PCB 市场增长承压，PCB 市场增速大幅下滑甚至出现负增长，产品市场需求变化以及行业竞争程度加剧，或者公司技术研发能力下降、新客户开拓及订单数量增长不及预期、公司竞争优势下降、亦或原材料采购价格持续大幅上涨导致公司毛利率水平下降等，给公司发展带来不利因素影响，公司募投项目新增产能存在难以及时消化或效益不及预期的风险，进而会对本次募投项目投资回报和公司经营业绩和盈利能力产生不利影响。

#### ③固定资产折旧增加的风险

本次募集资金投资项目完工后，新增固定资产及相应折旧费用将增加。若市场出现重大不利变化，募集资金投资项目建成后不能尽快达产或未能实现预期收益以消化新增的折旧费用，则公司存在因固定资产折旧费用增加而导致利润下滑的风险。

#### ④即期回报被摊薄的风险

本次募集资金到位后，公司股本和净资产将大幅增加。由于募集资金投资项目的实施和达产需要一定的建设周期，项目产生收益尚需一段时间，公司在本次发行完成后，存在短期内即期回报被摊薄（每股收益、净资产收益率下降）的风险。

### （2）与本次可转换公司债券相关的风险

#### ①可转债投资价值波动的风险

可转债作为一种复合型衍生金融产品，兼具债券和股票属性。本次发行可转

债存续期限较长，而影响本次可转债投资价值的市场利率与股票价格受到国家宏观经济形势、重大产业政策、全球经济形势、债券和股票市场的供求变化以及投资者的心理预期等多方面因素的影响。由于以上多种不确定性因素的存在，公司可转债价格可能会产生一定的波动，从而给投资者带来投资风险。

#### ②发行可转债到期不能转股的风险

股票价格不仅会受到公司盈利水平和业务发展的影响，还会受到宏观经济形势、国家产业政策、证券交易市场行情等因素的影响。如果出现公司股票价格低迷或者未达到债券持有人预期的情况，可能导致可转债未能在转股期内完成转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，公司将面临较大可转换公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司生产经营或募投项目正常实施的风险。

#### ③本次可转债本息兑付风险

在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。若未来公司遇到外部经营环境发生重大不利变化、经营状况及回款情况远低于预期等状况，公司的财务状况、资金实力或将恶化故而造成本息兑付压力增大，在上述情况下本次可转债投资者或将面临部分或全部本金和利息无法偿还的风险。

#### ④可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施或修正幅度不确定的风险

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，可转债存续期内，在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会仍可能基于公司业务发展情况、财务状况、市场趋势等多重考虑，不提出转股价格向下修正方案，或董事会虽提出了转股价格向下修正方案，但未能通过股东会的批准。若发生上述情况，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。

此外，若公司根据向下修正条款对转股价格进行修正，转股价格的修正幅度也受限于“修正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价”，转股价格向下修正幅度存在不确定性的风险。

#### ⑤提前赎回的风险

本次可转换公司债券设置了有条件赎回条款，可转债的存续期内，在相关条

件满足的情况下，如果公司行使了上述有条件赎回条款，可能促使本次可转债的投资者提前转股，从而导致投资者面临投资期限缩短、丧失未来预期利息收入的风险。

#### ⑥转股后摊薄即期回报的风险

本次可转债发行后，若可转债持有人在转股期开始后的较短时间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司股本和净资产将一定程度的增加，但本次发行募集资金投资项目从项目实施到收益的实现需要一定的周期，短期内无法完全实现项目效益，公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

#### ⑦可转债未担保的风险

公司本次向不特定对象发行的可转债未设定担保，提请投资者注意本次可转债可能因未设定担保而存在兑付风险。

#### ⑧信用评级变化的风险

公司本次发行的可转换公司债券已由中证鹏元评级，其中公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为稳定，本次可转债信用等级为“AA-”。在本次可转债存续期内，如果由于公司外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，从而导致本期债券的信用评级级别发生不利变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。

### （3）监管审核及发行失败风险

公司本次拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，尚需满足多项条件方可实施，本次发行能否通过审核并实施注册存在不确定性。本次发行的发行结果可能受到证券市场整体情况、公司经营业绩、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素影响，公司存在因发行认购不足导致发行中止甚至发行失败的风险。

## 二、本次证券发行基本情况

本次发行的具体情况详见《深圳市强达电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

发行证券的种类	可转换公司债券
发行数量	5,500,000 张
证券面值	100 元/张
发行价格	100 元/张
募集资金总额	不超过人民币 55,000.00 万元（含本数）
债券期限	自发行之日起 6 年
发行方式及发行对象	本次可转债的具体发行方式由股东会授权董事会（或由董事会授权的人士）与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。 本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定 的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
配售安排	本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。具体优先配售比例提请股东会授权董事会（或由董事会授权的人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的公告文件中予以披露。 本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金额，将通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足，则不足部分由保荐机构（主承销商）包销。具体发行方式由公司股东会授权董事会（或董事会授权的人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

### 三、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

#### （一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

保荐机构	保荐代表人	项目协办人	其他项目组成员
招商证券股份有限公司	刁雅菲、赵均	赵心宇	吴茂林、王喆、徐亮、石钟山

#### （二）保荐代表人主要保荐业务执业情况

##### 1、刁雅菲保荐业务执业情况

项目名称	工作职责	是否处于持续督导期间
深圳市强达电路股份有限公司创业板 IPO 项目	保荐代表人	是
湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票项目	保荐代表人	否，募集资金专项督导
深圳市创益通技术股份有限公司创业板 IPO 项目	项目组成员	否

## 2、赵均保荐业务执业情况

项目名称	工作职责	是否处于持续督导期间
深圳科瑞技术股份有限公司 IPO 项目	项目组成员	否
盛新锂能集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目	项目协办人	否

## （三）项目协办人主要保荐业务执业情况

项目名称	工作职责	是否处于持续督导期间
深圳市强达电路股份有限公司创业板 IPO 项目	项目组成员	是

## （四）保荐代表人、协办人、其他项目成员的联系地址及联系方式

保荐机构（主承销商）	招商证券股份有限公司
联系地址	深圳市福田区福华一路 111 号
联系电话	0755-82960432
传真	0755-82944669

## 四、保荐机构与发行人存在的关联关系

**1、保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况**

截至 2026 年 1 月 29 日，招商证券股票投资部未持有发行人股份；招商证券衍生投资部持有发行人股份共计 500 股，其中柜台持仓 500 股。

除上述情况外，不存在因本保荐机构或本保荐机构控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其实际控制人、重要关联方的股份而影响本保荐机构和其保荐代表人公正履行保荐职责的情况。

**2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况**

由于招商证券为 A 股及 H 股上市公司，除可能存在的少量、正常二级市场证券投资外，发行人及其实际控制人、重要关联方不存在直接或间接持有本保荐

机构或本保荐机构控股股东、实际控制人、重要关联方的股份的情形，也不存在影响本保荐机构和其保荐代表人公正履行保荐职责的情况。

### **3、保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、高级管理人员，持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况**

保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、高级管理人员，不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况。

### **4、保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况**

截至 2026 年 1 月 29 日，保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况；除上述说明外，本保荐机构与发行人不存在其他需要说明的关联关系。

### **5、保荐人与发行人之间的其他关联关系**

除上述说明外，本保荐机构与发行人不存在其他需要说明的关联关系。

上述情形不违反《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，不会影响保荐机构公正履行保荐职责。

## **五、保荐机构的承诺**

本保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，做出如下承诺：

(一) 本保荐机构已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本上市保荐书。

(二) 本保荐机构自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》第二十五条的规定，作出如下承诺：

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的

相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

9、中国证监会规定的其他事项。

(三) 本保荐机构承诺，自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

(四) 本保荐机构承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定，接受证券交易所的自律监管。

## 六、本次证券发行的决策程序

本保荐机构对发行人本次发行履行决策程序的情况进行了核查。经核查，本保荐机构认为，发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》及中国证监会和深圳证券交易所规定的决策程序，具体如下：

## （一）发行人董事会对本次证券发行上市的批准

2025年12月26日，发行人依法召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》等与本次发行上市相关的议案，并提请发行人股东大会审议。

## （二）发行人股东会对本次证券发行上市的批准、授权

2026年1月13日，发行人依法召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等与本次发行上市相关的议案。根据发行人2026年第一次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，发行人股东会已授权董事会及其授权人士在本次发行的决议有效期内全权办理本次发行的相关事宜。

# 七、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明

## （一）发行人符合《证券法》有关规定

### 1、符合《证券法》第十五条的相关规定

#### （1）具备健全且运行良好的组织机构

公司严格按照《公司法》《证券法》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，设立股东会、董事会、审计委员会及有关的经营机构，具有健全的法人治理结构。发行人建立健全了各部門的管理制度，股东会、董事会、审计委员会等按照《公司法》《公司章程》及公司各项工作制度的规定，行使各自的权利，履行各自的义务。

综上，公司具有健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十五条第一款第（一）项的规定。

### (2) 最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息

2022 年度、2023 年度、2024 年度，公司归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者计）分别为 8,194.72 万元、8,503.24 万元、9,774.50 万元，年均可分配利润为 8,824.15 万元。

本次向不特定对象发行可转债按募集资金 55,000.00 万元计算，参考近期可转换公司债券市场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付可转换公司债券一年的利息。

综上，本次发行符合《证券法》第十五条第一款第（二）项的规定。

### (3) 募集资金使用符合规定

本次募集资金拟用于“南通强达电路科技有限公司年产 96 万平米多层板、HDI 板项目”，资金投向符合国家政策，不存在用于弥补亏损和非生产性支出的情形。同时，发行人本次募集资金将按照公司债券募集办法所列资金用途使用，改变资金用途必须经债券持有人会议作出决议。

综上，本次发行符合《证券法》第十五条第二款的规定。

### (4) 本次向不特定对象发行可转债符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的条件

本次向不特定对象发行可转债符合中国证监会规定的条件，详见“(二) 发行人符合《上市公司证券发行注册管理办法》有关规定”，本次发行符合《证券法》第十五条第三款的规定。

## **2、不存在《证券法》第十七条不得再次公开发行公司债券的情形**

经核查，发行人不存在已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实且仍处于继续状态，不存在违反《证券法》规定改变公开发行公司债券所募资金的用途的情形，符合《证券法》第十七条的规定。

## （二）发行人符合《上市公司证券发行注册管理办法》有关规定

### 1、本次发行符合《注册管理办法》第九条第（二）项至第（五）项的规定

#### （1）现任董事、高级管理人员符合法律、行政法规规定的任职要求

保荐机构查阅了董事、高级管理人员简历、上述人员的声明等文件，查询了中国证监会及交易所网站并取得了发行人现任董事、高级管理人员的无犯罪证明。经核查，公司的现任董事、高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反《公司法》第一百七十八条、第一百八十一条规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责。公司现任董事、高级管理人员符合法律、行政法规规定的任职要求，符合《注册管理办法》第九条第二项的规定。

#### （2）具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，不存在对持续经营有重大不利影响的情形

保荐机构查阅了发行人的组织结构图、生产流程、中汇会计师出具的2022-2024年度《审计报告》以及2025年1-9月未经审计的财务报表、主要资产的权属证明文件、发行人声明、发行人相关公告等文件，访谈发行人高级管理人员，现场查看发行人主要生产经营场所。经核查，发行人与实际控制人祝小华的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理。发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，不存在对持续经营有重大不利影响的情形，符合《注册管理办法》第九条第三项的规定。

#### （3）会计基础工作规范，内部控制制度健全且有效执行，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允反映了上市公司的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告

保荐机构查阅和分析中汇会计师出具的无保留意见的《审计报告》《内部控制审计报告》、发行人的书面说明或承诺等文件，了解了发行人财务报表编制情况和内部控制状况。经核查，发行人已严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》和其他的有关法律法规、规范性文件的要求，建立了完善的公司内部控制制度。

发行人组织结构清晰，各部门和岗位职责明确，并已建立了专门的部门工作职责。发行人建立了专门的财务管理制度，对财务部门的组织架构、工作职责、财务审批等方面进行了严格的规定和控制。发行人建立了内部审计制度，设立内审部门，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。中汇会计师对发行人 2022 年度、2023 年度和 2024 年度财务报告进行了审计，均出具了标准无保留意见的审计报告，发行人财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。中汇会计师出具了《内部控制审计报告》，认为发行人于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

综上，发行人会计基础工作规范，内部控制制度健全且有效执行，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允反映了上市公司的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告，符合《注册管理办法》第九条第四项的规定。

#### （4）除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资

保荐机构查阅和分析发行人最近一期的财务报表。经核查，发行人最近一期末不存在金额较大的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，符合《注册管理办法》第九条第五项的规定

## 2、本次发行符合《注册管理办法》第十条的规定

保荐机构查阅了前次募集资金使用情况的专项报告、发行人的说明、发行人相关公告、发行人律师广东信达律师事务所出具的《关于深圳市强达电路股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》等文件，查询了中国证监会及交易所网站并取得了发行人现任董事和高级管理人员的无犯罪证明。经核查，发行人不存在以下情形，符合《注册管理办法》第十条的规定：

#### （1）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；

(2) 上市公司或者其现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；

(3) 上市公司或者其控股股东、实际控制人最近一年存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形；

(4) 上市公司或者其控股股东、实际控制人最近三年存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，或者存在严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为。

### **3、本次发行符合《注册管理办法》第十二条、第十五条的规定**

(1) 募集资金不得用于弥补亏损和非生产性支出

本次募集资金拟用于“南通强达电路科技有限公司年产 96 万平方米多层板、HDI 板项目”，资金投向符合国家政策，不存在用于弥补亏损和非生产性支出的情形。

(2) 符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定

保荐机构查阅了发行人募集资金投资项目的备案文件、南通市通州湾示范区行政审批局出具的发行人募集资金投资项目环评意见、募集资金投资项目的可行性分析报告、发行人的说明。经核查，发行人本次募集资金扣除发行费用后的净额拟用于“南通强达电路科技有限公司年产 96 万平方米多层板、HDI 板项目”，符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规的规定。

(3) 除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司

保荐机构查阅了本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书、募集资金投资项目的可行性分析报告、发行人 2026 年第一次临时股东会决议。经核查，本次募集资金扣除发行费用后的净额拟用于“南通强达电路科技有限公司年产 96 万平方米多层板、HDI 板项目”，不属于用于持有财务性投资，未直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，符合上述规定。

(4) 募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性

保荐机构查阅了募集资金投资项目的可行性分析报告，核查了控股股东、实际控制人及其控制的其他企业主营业务信息，获取了发行人书面说明。经核查，发行人本次募集资金投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生重大不利的同业竞争、显失公平的关联交易，或严重影响公司生产经营的独立性，符合上述规定。

#### **4、本次发行符合《注册管理办法》第十三条的规定**

##### **(1) 具备健全且运行良好的组织机构**

公司严格按照《公司法》《证券法》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，设立股东会、董事会、审计委员会及有关的经营机构，具有健全的法人治理结构。发行人建立健全了各部门的管理制度，股东会、董事会、审计委员会等按照《公司法》、《公司章程》及公司各项工作制度的规定，行使各自的权利，履行各自的义务。

综上，公司具有健全且运行良好的组织机构，符合《注册管理办法》第十三条第一款第一项的规定。

##### **(2) 最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息**

根据公司最近三年审计报告，2022 年度、2023 年度、2024 年度，公司归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者计）分别为 8,194.72 万元、8,503.24 万元、9,774.50 万元，年均可分配利润为 8,824.15 万元。参考近期可转换公司债券市场的发行利率水平并经合理估计，发行人最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，符合《注册管理办法》第十三条第一款第二项的规定。

##### **(3) 具有合理的资产负债结构和正常的现金流量**

根据查阅和分析中汇会计师出具的 2022-2024 年度审计报告以及 2025 年 1-9 月未经审计的财务报表，报告期各期末，发行人合并口径的资产负债率分别为 41.26%、35.26%、21.85% 和 24.98%，总体资产负债结构较为稳定，长期偿债风险较小。本次发行完成后，发行人的总资产和总负债规模均有所增长。随着未来可转换公司债券持有人陆续实现转股，发行人负债规模将逐步下降，净资产规模将逐步上升，资产负债率将逐步降低。

报告期内，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 10,104.53 万元、13,563.06 万元、10,877.97 万元和 9,494.83 万元。发行人经营活动现金流量金额持续为正。

截至 2025 年 9 月末，公司净资产为 114,708.03 万元。本次拟发行可转换公司债券不超过 55,000.00 万元（含本数），假设本次可转换公司债券按最高额 55,000.00 万元计算，则本次发行完成后公司累计债券余额不超过最近一期末净资产的 50%，资产负债结构保持在合理水平。

综上，公司本次发行符合《注册管理办法》第十三条第一款第三项的规定。

## 5、本次发行符合《注册管理办法》第十四条规定

经核查，发行人不存在《注册管理办法》第十四条规定下述不得发行可转债的情形：(1) 对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍处于继续状态；(2) 违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募资金用途。

## 6、本次发行符合《注册管理办法》第十六条规定

2025 年 12 月 26 日，发行人依法召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》等与本次发行上市相关的议案。

2026 年 1 月 13 日，发行人依法召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》等与本次发行上市相关的议案。

本次发行董事会决议日与发行人首次公开发行股票上市日的时间间隔不少于六个月。

综上，发行人本次发行符合《注册管理办法》第十六条的相关规定。

## **7、发行人本次发行符合《注册管理办法》第四十条的规定**

为推动公司业务发展，进一步增强公司竞争力，优化公司财务结构，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 55,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于“南通强达电路科技有限公司年产 96 万平米多层板、HDI 板项目”，符合公司主营业务。本次发行募投项目的实际投资建设资金需求，系综合考虑公司资金缺口、目前的资本结构等因素后确定的融资规模，具有合理性。本次募集资金金额及投向均具有合理性。

综上，发行人本次发行符合《注册管理办法》第四十条的相关规定的“上市公司应当理性融资，合理确定融资规模，本次募集资金主要投向主业。”

## **8、发行人本次发行符合《注册管理办法》第六十一条的规定**

保荐机构查阅了发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书、董事会及股东会审议文件等文件。经核查，发行人本次发行可转换公司债券的期限、面值、利率等规定如下：

### **(1) 债券期限**

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。

### **(2) 债券面值**

本次发行的可转债每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。

### (3) 债券利率

本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

### (4) 债券评级

公司聘请中证鹏元为本次发行的可转债进行信用评级，本次可转债主体信用评级及债券信用评级均为“AA-”。在本次可转债存续期内，资信评级机构每年至少出具一次跟踪评级报告。

### (5) 债券持有人权利

公司制定了可转换公司债券持有人会议规则，约定了保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

### (6) 转股价格及调整原则

本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在本次发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况而调整的情形，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

其中： $P_0$  为调整前转股价， $n$  为送股或转增股本率， $k$  为增发新股或配股率， $A$  为增发新股价或配股价， $D$  为每股派送现金股利， $P_1$  为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体（以下简称“符合条件的信息披露媒体”）上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

#### （7）赎回条款

##### ①到期赎回条款

在本次可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的本次可转债。具体赎回价格提请股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

##### ②有条件赎回条款

在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日起至本次

可转债到期日止。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外，当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司董事会（或由董事会授权的人士）有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。

#### （8）回售条款

##### ①附加回售条款

若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会、深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。

##### ②有条件回售条款

在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的 70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。

最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。

#### （9）转股价格向下修正条款

##### ①修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会将有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

##### ②修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申

请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

### ③转股价格不得向上修正

公司本次向不特定对象发行可转债的转股价格应当不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价，且不得向上修正。

综上，发行人本次发行可转换公司债券具有期限、面值、利率、评级、债券持有人权利、转股价格及调整原则、赎回及回售、转股价格向下修正等要素，且发行的可转换公司债券利率由上市公司与保荐机构（主承销商）依法协商确定，符合《注册管理办法》第六十一条的规定。

## 9、发行人本次发行符合《注册管理办法》第六十二条的规定

保荐机构查阅了发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书。经核查，发行人本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一交易日起至可转换公司债券到期日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股次日成为上市公司股东。

综上，发行人本次发行符合《注册管理办法》第六十二条的规定。

## 10、发行人本次发行符合《注册管理办法》第六十四条的规定

保荐机构查阅了发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书。经核查，发行人本次可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。具体初始转股价格由公司股东会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

综上，发行人本次发行符合《注册管理办法》第六十四条的规定。

## 八、保荐机构关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和依据，以及保荐机构的核查内容和核查过程

### （一）保荐机构关于发行人符合板块定位及国家产业政策的说明

#### 1、符合国家产业政策

发行人所属行业为“C3982 电子电路制造”，主营业务为 PCB 的研发、生产和销售，本次募集资金投向“南通强达电路科技有限公司年产 96 万平方米多层板、HDI 板项目”，围绕主营业务开展。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”之“C3982 电子电路制造”。本次募投项目紧密围绕主营业务展开，符合国家产业政策鼓励的方向，不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的淘汰类、限制类产业，不属于产能过剩行业。

2019 年以来，国家主要政府机构陆续颁布《印制电路板行业规范条件》《关于推动 5G 加快发展的通知》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》《“十四五”数字经济发展规划》《数字中国建设整体布局规划》《制造业可靠性提升实施意见》《算力基础设施高质量发展行动计划》《产业结构调整指导目录（2024 年本）》《关于推动未来产业创新发展的实施意见》《广东省建设现代化产业体系 2025 年行动计划》《电子信息制造业 2025-2026 年稳增长行动方案》等一系列促进印制电路板行业及其下游应用领域的产业政策，在智能终端、5G、工业互联网、数据中心和新能源汽车等重点行业推动电子元器件差异化应用。

#### 2、符合板块定位

本次募投项目为首次公开发行股票的募集资金投资项目，该项目已启动建设。由于首次公开发行中，公司实际募集资金净额与项目需要的总投资存在资金缺口，拟通过本次向不特定对象发行可转债予以补充，以推动项目顺利实施。公司本次

向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金扣除发行费用后，将全部用于本次预案董事会决议后的建筑安装工程费、设备购置及安装等资本性支出，本次募投项目不涉及补充流动资金的情形。

本次募集资金投向与公司既有业务的关系如下：公司本次募集资金投资项目围绕主营业务开展，是基于未来发展战略及行业市场机遇而实施，本次募投项目与公司既有业务密切相关。公司深耕 PCB 行业二十余年，专注于中高端样板和小批量板的 PCB 研发、生产及销售。公司凭借快速响应、柔性生产、精细管理、智能制造和优异的服务水平，致力于满足客户电子产品在研究、开发、试验和小批量阶段对 PCB 的专业需求，产品广泛应用于工业控制、通信设备、汽车电子、消费电子、医疗健康和半导体测试等应用领域。公司本次募投项目产品为已有产品，是在公司现有 PCB 业务基础上发展而来，在原有的应用领域基础上，更加聚焦 AI 服务器及算力、卫星通信、工业自动化、汽车电子等新兴领域。

本次募集资金投资项目将紧密围绕行业增长动力，提升 HDI、高多层板生产能力，满足市场对高层数、高密度、高性能产品的快速交付需求，是对公司现有业务的延伸和拓展。项目的实施，将有助于提高公司的生产能力，优化产品结构，有助于提升公司生产安排的协调反应能力，增强公司的市场竞争力，提高公司盈利水平，进一步巩固公司在行业中的竞争地位。

综上，本次募投项目紧密围绕发行人主营业务开展，本次发行满足《注册管理办法》第三十条关于符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）的规定。

## （二）保荐机构的核查内容和核查过程

保荐机构主要履行了如下核查程序：

- 1、查阅《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)、《战略性新兴产业分类(2018)》《产业结构调整指导目录(2024年本)》等相关法规、政策文件或指导目录，核查发行人本次募投项目是否符合国家产业政策；
- 2、分析发行人主营业务概况及其所在印制电路板(PCB)行业发展现状，查询行业报告和行业数据，查阅同行业可比公司招股说明书、定期报告等资料，了

解发行人所处行业的下游需求、行业市场空间及未来发展趋势等内容；

3、查阅了发行人募集资金投资项目的备案文件、南通市通州湾示范区行政审批局出具的发行人募集资金投资项目环评意见、募集资金投资项目的可行性分析报告；

4、与发行人管理层进行沟通，了解募投项目的具体投入情况，产品构成情况。

经核查，发行人本次发行符合国家产业政策及板块定位要求。

## 九、保荐机构对发行人持续督导期间的工作安排

事项	工作计划
(一) 持续督导事项	在本次发行可转债上市当年的剩余时间及以后 2 个完整会计年度内对发行人进行持续督导。
1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度。	1、强化发行人严格执行中国证监会和深圳证券交易所相关规定的意识，进一步完善各项管理制度和发行人的决策机制，协助发行人执行相关制度； 2、与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
2、督导发行人有效执行并完善防止高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度。	1、督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内部控制制度； 2、与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见。	1、督导发行人进一步完善关联交易的决策制度，根据实际情况对关联交易决策权力和程序做出相应的规定； 2、督导发行人遵守《公司章程》中有关关联股东和关联董事回避的规定； 3、督导发行人严格履行信息披露制度，及时公告关联交易事项； 4、督导发行人采取减少关联交易的措施。

事项	工作计划
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件。	1、督导发行人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务； 2、在发行人发生需进行信息披露的事件后，审阅信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件。
5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项。	1、督导发行人严格按照募集资金用途使用募集资金； 2、要求发行人定期通报募集资金使用情况； 3、因不可抗力致使募集资金运用出现异常或未能履行承诺的，督导发行人及时进行公告； 4、对确因市场等客观条件发生变化而需改变募集资金用途的，督导发行人严格按照法定程序进行变更，关注发行人变更的比例，并督导发行人及时公告。
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关文件的要求规范发行人担保行为的决策程序，要求发行人对重大担保行为与保荐机构进行事前沟通。
7、持续关注发行人经营环境和业务状况、股权变动和管理状况、市场营销、核心竞争力以及财务状况。	与发行人建立经常性信息沟通机制，及时获取发行人的相关信息。
8、根据监管规定，在必要时对发行人进行现场检查。	定期或者不定期对发行人进行回访，查阅所需的相关材料并进行实地专项核查。
(二) 保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	1、保荐机构履行保荐职责，可以要求发行人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》规定、本协议约定的方式，及时通报信息； 2、保荐机构履行保荐职责，定期或者不定期对发行人进行回访，查阅保荐工作需要的发行人材料； 3、保荐机构履行保荐职责，可以列席发行人董事会及股东会； 4、保荐机构履行保荐职责，对发行人的信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件进行事前审阅等。
(三) 发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定	发行人已在保荐协议中承诺配合保荐机构履行保荐职责，协助保荐机构对发行人及其控股股东、实际控制人进行尽职调查、审慎核

事项	工作计划
	查，协助保荐机构组织编制申请文件；及时向保荐机构及主承销商提供真实、准确、完整的资料、文件和数据，以便双方能及时完成有关工作，并对所提供的文件和资料的真实性、完整性、准确性负责；协助保荐机构组织协调中介机构及其签名人员参与证券发行上市的相关工作等。
(四) 其他安排	本保荐机构将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的各项要求对发行人实施持续督导。

## 十、保荐机构认为应当说明的其他事项

无其他需要说明的事项。

## 十一、保荐机构对本次证券上市的推荐结论

本保荐机构认为：深圳市强达电路股份有限公司符合《公司法》《证券法》及《上市规则》等法律、法规的相关要求，本次向不特定对象发行的可转换公司债券具备在深圳证券交易所上市的条件。本保荐机构同意推荐深圳市强达电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市，并承担相关保荐责任。

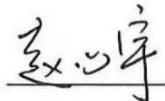
特此推荐，请予批准。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《招商证券股份有限公司关于深圳市强达电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书》之签章页)

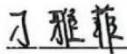
项目协办人

签名: 赵心宇

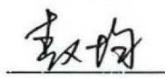


保荐代表人

签名: 刁雅菲



签名: 赵均



内核负责人

签名: 吴晨



保荐业务负责人

签名: 刘波



法定代表人

签名: 霍达



2026年2月4日